

希荻微电子集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告

为积极响应关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2025 年度行动方案”）并已于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露。公司现对 2025 年度行动方案在 2025 年上半年的实施情况进行全面评估并编制了本评估报告，具体内容如下：

一、 专注公司主业，持续提升核心竞争力

（一） 持续扩充产品料号以满足下游应用多样化需求

在消费电子领域，公司始终聚焦技术创新与场景化应用，通过覆盖智能终端核心需求的模拟芯片解决方案持续推动用户体验升级。2025 年上半年，公司针对移动设备能效管理痛点，自主研发的开关充电芯片 HL7010 显著提高充电效率，实现更快速、环保的充电体验；同步开发的接口保护芯片 HL5081 集成多重安全防护机制，有效保障各类电子设备在复杂工况下的稳定运行。公司产品矩阵已形成从芯片设计到终端应用的完整技术闭环，为全球主流消费电子品牌的产品迭代提供关键技术支持，助力构建更安全高效的智能设备生态体系。

车载电子领域是公司重点布局的产品应用领域之一。2025 年上半年，公司聚焦智能座舱、汽车天线、车身控制、高级驾驶辅助系统（ADAS）等下游应用场景，推出了多款车载系列新产品，如双通道高边开关芯片 HL85216 和 HL85214、8 通道电源开关芯片 HL85875、单通道低边开关芯片 HL85103L 和 HL85105L，为汽车制造商的关键应用提供多功能和全面的电源管理解决方案。报告期内，公司车规芯片的销售体量持续增加，并成功导入多家国内头部汽车品牌供应链。

针对服务器、数据中心等应用，公司自主研发的 CPU、GPU、DSP 等核心

处理器供电芯片，具备革命性的创新架构以及全球一流的负载瞬态响应，输出电流高达 50A，效率高达 90%以上，多路并联可输出更高规格的电流，与国际品牌的成熟方案相比，更加能够满足服务器对电源模块小型化、高效化的需求。此外，公司推出的 20A/50A 大电流 E-fuses 负载开关芯片等系列产品在电流极限精度和响应时间等关键指标上也表现不凡。

作为基于硅负极锂电池技术开发的 DC-DC 电源管理芯片，HL7603 自 2024 年初上市以来便展现出强劲的市场竞争力。凭借其出色的性能和适配性，该产品已成功实现向小米、vivo、OPPO、传音、联想等全球知名品牌客户的批量出货，为其 AI 手机、AI 眼镜等智能终端电子设备提供了强大的长续航支持。在获得行业头部客户验证的背景下，HL7603 于 2025 年 6 月被评定为“2025 年第一批广东省名优高新技术产品”，标志着公司在新能源电源管理芯片领域的技术创新成果获得权威认可。

（二）内生与外延发展并重，巩固和拓展市场份额

2025 年上半年，受下游市场需求带动，公司实现营业收入 46,644.93 万元，较上年同期增长 102.73%。此外，公司通过积极参加线下展会及论坛活动，如 2025 国际电力电子应用展览会（APEC）、2025 上海慕尼黑电子展、第二十一届上海国际汽车工业展览会等，展示了技术实力和创新成果，进一步提高了公司品牌知名度和市场竞争力。

2025 年上半年，公司继续发挥音圈马达驱动芯片产品线与公司电源管理芯片、端口保护和信号切换芯片的协同效应，进一步增加了与现有客户的合作粘性并提升了在行业内的知名度。在协同效应的作用下，公司芯片产品的出货规模大幅提升。同时，公司继续积极、有序推进智能视觉感知业务的自产工作，进一步增加自产产品的数量，逐步提升公司营收规模和盈利能力。2025 年上半年，公司音圈马达驱动芯片产品线实现营业收入 14,193.99 万元，占公司营收的 30.43%。

2024 年 11 月，公司发布了以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）相关公告，2025 年 5 月 13 日，公司已收到上海证券交易所关于本次重大资产重组的审核问询函，目前公司正积极推进相关工作。本次重大资产重组尚需上海证

券交易所审核通过和中国证监会注册通过，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次重大资产重组的进展情况。

（三）全方位优化内部管理努力实现“降本增效”

2025 年上半年，公司继续全面推进降本增效建设。公司通过强化成本管控意识，建立严格的成本考核机制，对各部门的成本控制情况进行量化考核，确保降本增效目标的实现。2025 年上半年，销售费用、研发费用及管理费用三费合计占收入比重较去年同期下降 43.32%；归属于母公司所有者的净亏损较去年同期减少 7,285.09 万元，净利润亏损显著收窄，降本增效取得显著成果。

在 AI 技术深度重构企业运营的产业变革中，公司主动拥抱 AI 技术浪潮，开启公司智能化发展新篇章。在 2025 年上半年，公司已接入基于 DeepSeek 模型的提效工具实现办公系统升级，通过自动化文档处理与智能数据分析提升运营效能，同步强化跨部门协同效率与决策精准度。在技术攻坚层，公司正在积极探索 AI 与芯片设计的深度融合，以效缩短研发周期并实现缺陷率优化。公司正持续完善从基础运营到核心研发的全链路 AI 赋能体系，以智能化创新驱动公司高质量发展。

（四）研发战略优化升级加速公司创新成果转化

2025 年上半年，公司的研发费用为 13,365.03 万元，较去年同期增长 11.18%。持续高水平的研发投入保证了公司技术和产品的先进性，进一步提高了公司的市场竞争力。其中，公司通过扩充专业技术梯队，实现研发实力的稳步提升，截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 208 人，占员工总数量的 60.47%。

公司围绕核心技术持续发力，密切关注市场需求及行业前沿发展趋势，通过对新产品、新技术持续的研发投入，在技术创新和产品研发领域有较强的先发优势，对后续进入市场的竞争者构筑了技术及专利壁垒。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计取得国内外专利 247 项，均为发明专利，另有集成电路布图设计专有权 14 项。其中，在 2025 年上半年获得新增授权专利 7 项，新增集成电路布图设计专有权 2 项。

2023 年 6 月，公司以“可配置的多通道高/低边驱动芯片”项目参加北京市科技技术委员会、中关村科技园区管理委员会举办的 2023 年度车规级芯片科技

攻关“揭榜挂帅”榜单任务，并成功立项。2025 年上半年，该项目已经成功通过验收，项目团队已按要求完成考核指标，所设计的产品全面满足车规级芯片性能要求并通过严苛的可靠性验证，为国产汽车电子产业链提供了支撑。此外，该项目在实施过程中亦产生了多项集成电路布图设计专有权。

（五） 稳健的人才政策打造多元化、高效能的人才队伍

在人才培养方面，公司始终秉持“以人为本”的人才理念，注重员工的个人成长和职业规划，公司为员工提供了多元化的职业发展通道，并通过轮岗、竞聘等培养机制，帮助员工在不同的岗位上发挥所长，实现职业晋升。此外，公司在 2025 年上半年组织了一系列高管与员工间的面对面交流会议，旨在高效同步公司业务进展的最新动态，清晰阐明年度战略发展方向，并积极践行简单、透明的沟通文化，促进信息的有效流通与理解。

截至本报告出具之日，公司 2024 年股票期权激励计划首次（预留）授予部分第一个行权期所设定的公司层面业绩考核指标已经达成，共计 113 名激励对象符合当期行权条件。员工股权激励的常态化推进和落地，充分调动了公司核心骨干工作积极性，并向资本市场传递了公司的长期成长预期。

二、 优化财务管理水平，提升经营效率与效果

2025 年上半年，公司合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，同时节省各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营决策效率和盈利水平。

在存货管理方面，公司通过加强供应链管理、提升销售预测的准确性，合理调度采购与生产的节奏，提高存货周转率。2025 年上半年，公司存货周转率为 205.27%，较去年同期增加 121.86 个百分点。应收账款管理方面，公司通过制定合理的信用政策，全方位评估客户信用，加强应收账款风险管理，重点跟进逾期欠款的催收进度，及时减少坏账损失，提高应收账款周转率。2025 年上半年，公司应收账款周转率为 277.19%，较去年同期增加 62.02 个百分点。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	累计使用比例（%）	进度情况
1	高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目	20,617.79	19,777.91	95.93	预计在 2025 年下半年完成投入，达到预期可使用状态。该项目能更好地满足电源管理芯片下游消费电子类产品市场的庞大需求，不断提升公司的持续经营能力和盈利能力。
2	新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目	8,531.56	7,086.04	83.06	报告期内，公司车规芯片的销售体量持续增加，并成功导入多家国内头部汽车品牌供应链。
3	总部基地及前沿技术研发项目	20,019.66	7,480.81	37.37	公司正在进行总部基地建设项目的主体结构工程建设，预计在 2025 年下半年完成主体结构工程封顶以及推进水电、消防、幕墙等工程施工。

2025 年下半年，公司将继续严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，持续加强募投项目管理，切实保障募投项目按计划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展。

三、 完善公司治理，走高质量发展之路

（一）完善公司治理制度，促进公司规范运作

2025 年上半年，公司通过不断完善治理结构、优化业务流程，并紧密结合法律法规的更新及公司实际运营情况，持续改进内部控制体系。同时，公司持续深化落实内部审计工作，重点开展内部专项审计，通过内部审计助力公司合规运

行。此外，公司将反舞弊工作与治理提升相结合，在依法追究前员工不当行为的基础上，吸取教训，以事件为契机优化管理体系；通过开展诚信廉洁、知识产权保护等培训课程，进一步强化全体员工践行合规的价值体系。

2025 年下半年，公司将根据新《公司法》及证监会、上海证券交易所下发的一系列法规规定的要求，在过渡期内完成公司内部监督机构的调整，并相应修订、完善《公司章程》及相关制度。

（二）强化“关键少数”责任，提高其合规履职能力

2025 年上半年，公司继续强化“关键少数”责任，提高其合规履职能力，主要体现在：

1. 公司及董监高持续配合保荐机构和独立董事进行的日常沟通、现场调查等工作，以加强对董监高合规履职的监督，同时公司配备专职人员实时响应其关于经营与监管的咨询，推动建议转化为管理实效。

2. 公司严格监督股东的承诺履行情况，坚决杜绝违规减持行为，切实履行公司的责任和义务，保护投资者的合法权益。

3. 公司已建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制，提示上述人员避免出现违规增减持、短线交易和内幕交易等违法违规行为。

4. 公司积极组织实际控制人以及董监高等“关键少数”参加由证监局、上海证券交易所、上市公司协会等监管单位举办的各类培训，使“关键少数”更加准确地理解最新的监管理念和规则要求，提高其履职能力。

四、 加强投资者沟通，传递公司价值

2025 年 4 月 29 日，公司在公众号上发布了“一图读懂 2024 年年报及 2025 年一季报业绩”，采用可视化形式为投资者解读公司经营发展，以简明友好的方式直观呈现经营成果，积极传递公司内在价值。2025 年上半年，公司开设了抖音、微视频等账号，在该等新媒体平台上呈现公司的成长性与核心价值，动态披露经营成果，为投资者提供更为丰富和立体的信息参考，增强投资者参与度和认知度。

2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，针对公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者

进行互动交流和沟通。2025 年上半年，公司通过上海证券交易所“e 互动”平台回复投资者问题共计 30 条，回复率为 100%；开展投资者活动共计 7 场；通过电话热线接听投资者咨询 27 条；召开了 3 次股东大会，累计出席股东人数 300 人，充分保障了投资者的股东权利。公司通过上述多元渠道，快速响应投资者诉求，保持投资者粘性。

五、 其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

（以下无正文）

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日